

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐一对一沟通 ☒其他（电话会议）
参与单位 及人员	中海基金、长城基金、江信基金、前海开源、申万菱信、光大保德信、富国基金、国泰基金、海富通基金、创金合信、交银施罗德、诺德基金、华安基金、圆信永丰、鑫元基金、泰信基金、银河基金、鹏华基金、新华基金、华宝基金、诺安基金、平安基金、汇丰晋信、永赢基金、中信保诚、招商基金、韩国投资信托、Willing Capital、霸菱资管、摩根基金、博时基金、兴全基金、乾图基金、国泰君安、国泰海通、申万宏源、中银证券、东北证券、招商证券、中邮证券、国信证券、国信资管、西部证券、银河证券、华创证券、长城证券、国海证券、中原证券、浙商自营、中信里昂、中英人寿、平安养老、太平养老、国寿养老、中再资产、华夏理财、建信理财、人保资产、渤海人寿、长江资管、海宸投资、禹田投资、汐泰投资、伯利恒资产、东方睿石、喜世润投资、尚诚资产、五地私募、银叶投资、衍复投资、金石投资、明河投资、路伯迈、榕树投资、美阳投资、固禾资产、泾溪投资、创富兆业、红杉资本、途灵投资、乐信投资、禹田资本、华夏财富创新、统一投资、兴业银行、东芯投资
时间	2026 年 8 月 28 日
地点	线上会议
接待人员	董事会秘书常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、2026年上半年业绩的说明 报告期内，公司采取措施继续优化成本和产品结构，进一步完善产品技术指标并拓展销售网络，加强研发工作，力图不断满足新增市场需求。公司实现营业收入21,640.56万元，相比去年同期增长3.78%；取得归属于上市公司股东的净利润4,108.54万元，相比去年同期下降15.87%。公司在确保生产质量和产能扩张的同时，优化了客户结构和销售结构，夯实了经营基础。 二、大直径硅材料业务的说明

	大直径硅材料业务受到海外市场景气度提升带动，实现营业收入13,513.72万元，同比增长46.05%，较去年同期有较大幅度增长； 根据国际主流刻蚀机设备厂商和集成电路制造厂商披露的财务数据，集成电路制造厂商产能利用率持续提升，存量市场向好。 公司将根据市场需求情况实施大直径硅材料业务的产能扩充。公司还将密切跟踪国际半导体供应链的重组态势，善用公司多年深耕海外市场所积累的经验 and 资源，扩大面向海外市场的出口产品品类和数量，响应供求关系和成本端的变化，适时适度地调整产品销售价格。 三、硅零部件业务的说明 硅零部件业务受下游客户采购计划调整的影响，报告期内实现营业收入6,899.07万元，同比减少38.57%。公司在按照既定战略持续扩充产能的同时，针对性地优化产能配置和客户结构，已取得成效；公司具备“从硅材料到硅零部件”的全产业链优势以及前瞻性研发布局，技术储备雄厚、产品种类丰富，且产品结构聚焦于高技术、高毛利产品。 公司认为，长期高品质大批量交付能力的构建，重要性大于短期订单波动。公司硅零部件产品已经全面导入国产等离子刻蚀机设备厂商及集成电路制造厂商，客户结构得以优化，未来有望获得更大的成长空间和更强的成长动能。 四、半导体大尺寸硅片业务的说明 半导体大尺寸硅片业务受益于行业整体回暖和竞争格局改善。公司抓住市场机遇，已经实现面向重点客户的小批量出货，利基细分市场培育亦取得显著成果，开工率有所提升。报告期内，该业务实现营业收入1,110.33万元，同比增长达268.98%，毛利率为-5.05%，较去年同期明显提升并接近转正。报告期内，公司投资设立了全资子公司北方晶圆半导体科技（北京）有限公司作为该业务未来高质量差异化发展的承载主体。 五、新增重要非主营业务的说明 公司通过控股子公司锦州精辰半导体有限公司，开展碳化硅陶瓷零部件业务。碳化硅陶瓷零部件具备耐高温、耐等离子腐蚀、高热导率、高纯度等优异特性，可广泛应用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入、外延、退火、氧化、扩散等多类半导体设备，是先进制程芯片制造的关键核心耗材。公司计划实施“碳化硅陶瓷
--	--

	零部件研发及产业化建设项目”，有望实现高纯碳化硅陶瓷零部件的研发与产业化落地，进一步完善“硅基材料+硅基部件+陶瓷部件”平台化产品布局，拓展产品应用场景与市场空间，提升综合竞争力与持续经营能力。 六、市场展望及经营计划 展望下半年市场机遇，公司认为，中国本土厂商以超大规模国内统一大市场为基础，通过“规模降本-技术迭代-产业链闭环-建立行业标准”的路径，后发先至取得全球产业竞争制高点之范式，在过去十年的 LCD 面板、光伏、动力电池、碳纤维等领域得到反复验证。因此，中国本土芯片制造厂商有望加速成长为世界级公司。 相比海外竞争对手的积累而言，包括公司在内的本土半导体材料和零部件企业，普遍设立时间较短、经验有限、资源不足。如何在短时间内匹配世界级客户的世界级需求，既是挑战更是机遇。国产化的战略任务，对中国本土厂商的生产管理、供应链建设、智能化管理水平、资本运作能力乃至企业文化建设，提出了全方位的跃升要求。用进废退，不进则退，产业竞争已经从“资格赛”和“小组赛”，进入到“排位赛”和“淘汰赛”。 公司积极主动地应对上述产业机遇、战略任务和竞争态势。报告期内，公司第三届董事会第十四次会议和 2026 年第二次临时股东会通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，计划向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 100,000 万元，投向三大项目——“硅零部件扩产项目”、“碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目”、“研发中心建设项目”。 公司将积极把握半导体市场特别是存储芯片市场境内外“同频共振”的历史机遇，计划实现大直径硅材料业务境外市场的收入突破，保质保量完成硅零部件业务的产能扩充并持续优化客户结构，推动半导体大尺寸硅片业务的盈利能力改善和高质量差异化发展。公司还将密切研判当前地缘政治经济宏观事件频发态势下的国际半导体供应链重组动向，善用公司多年深耕海外市场所积累的经验 and 资源，为股东创造价值。
附件清单	无

日期	2026 年 8 月 31 日
----	-----------------